



8412 ACF

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



conductive HAF เทป สีเหลืองอำพัน 45 ไมครอน

Product Description

tesa® HAF 8412 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน สีเหลืองอำพัน ประกอบด้วย phenolic resin และ nitrile rubber และมีอนุภาคที่เป็นสื่อไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิพและการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนเดียว
- สามารถใช้การได้ดีกับสายการผลิตฝังชิพทั่วไป
- เหมาะสำหรับการ์ด DI วัสดุ PVC, ABS, PET และ PC
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ

ความหนา: 45 µm (ค่ากลางของขนาดอนุภาค)

คุณสมบัติ

- Excellent grounding performance in applications with structural bonding requirements
- High bonding strength in narrow and small bonding areas
- Good ageing resistance
- Reliable SmartCard chip bonding and electrical connectivity in one step
- Suitable for PVC, ABS and PC SmartCards (DI)

การใช้งาน

tesa® HAF 8412 ออกแบบสำหรับการฝังชิพโมดูลลงในสมาร์ทการ์ดชนิด dual interface

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| • Backing | none | • Total thickness | 50 µm |
| • Type of adhesive | nitrile rubber / phenolic resin | • Color | สีเหลืองอำพัน |
| • Type of liner | glassine | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|--------|
| • Bonding strength | 4 N/mm ² | • อุณหภูมิที่ให้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา | 120 °C |
| • ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z | 200 mOhm | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08412>



8412 ACF

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพารามิเตอร์ของเครื่องมือที่จะใช้ในเบื้องต้น โปรดทราบว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักร รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด ซิปโมดูลและข้อกำหนดของลูกค้า

1. การเคลือบเบื้องต้น:

ช่วงการติดเคลือบเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบบนสายพานโมดูล ขั้นตอนการเคลือบเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบต่ออายุของเทป สายพานโมดูลที่ได้รับการเคลือบติดเทปสามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยใช้เวลาเท่ากับอายุการใช้งานของเทป

การตั้งค่าเครื่องจักร:

*อุณหภูมิ 130 – 150 °C

*แรงกดทับ 2 – 3 บาร์

*ความเร็ว 1.5 – 2.5 ม./นาที

2. การฝังโมดูล:

ระหว่างการผลิต

โมดูลที่เคลือบจะถูกดันออกจากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าไปในช่องของบัตรและติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตรโดยความร้อนและแรงกดทับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ implanting line สามารถใช้วิธีการกดทับขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนก็ได้

ปัจจุบันเครื่องฝังซิปส่วนใหญ่ใช้แรงกดด้วยความร้อนแบบหลายขั้นตอน

ขั้นตอนเดียว - การตั้งค่าเครื่อง:

*อุณหภูมิ 180 – 220 °C

*แรงกดทับ 80 – 130 N/โมดูล

*เวลา 1.5 วินาที

กระบวนการหลายขั้นตอน (การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) – การตั้งค่าเครื่อง:

*อุณหภูมิ 180 - 220 °C

*แรงกดทับ 80 - 130 N/โมดูล

*เวลา 2 x 0.7 s / 3 x 0.5 วินาที

อุณหภูมิตามที่วัดได้ภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน มีข้อเสนอแนะการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุบัตรที่แตกต่างกัน ดังนี้:

PVC 180 – 190 °C

ABS 180 – 190 °C

PET 190 – 200 °C

PC 200 – 220 °C

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาวะการเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางอายุการเก็บรักษาของ tesa® HAF



8412 ACF

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08412>